

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2026-023

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“立昂微”）积极贯彻落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，现结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，总结 2025 年度主要工作并制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容公告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025 年，依托行业复苏契机，叠加下游客户需求增长与公司市场拓展、产品结构优化的双重驱动，公司主营业务实现高质量增长，公司三大业务板块营收均取得较大增长，企业整体发展态势稳健向好，为后续持续发展筑牢了坚实基础。

（1）公司半导体硅片业务产品结构持续优化，核心竞争力显著增强。6-12 英寸功率器件用重掺硅片居国内市场领先地位；12 英寸及 8 英寸重掺磷、重掺砷超低阻衬底外延产品通过客户验证并量产供应，12 英寸 MCZ 超低氧抛光片精准切入国内外高压 IGBT 市场并成功上量。高端产品表现亮眼，面向 AI 服务器、数据中心、工业自动化等领域所用 12 英寸重掺砷/磷外延片销量显著增长，多款产品打破国际垄断。

（2）公司功率器件芯片业务稳步发展，虽整体营收小幅承压，但通过持续优化产品结构，高附加值产品表现突出，实现了高质量发展。FRD 芯片表现亮眼，成为业务增长的核心引擎。公司车规级产品比例不断提升，是博世、大陆集团、法格电子、台湾半导体、安世等国际顶级汽车电子厂商的合格供应商，是比亚迪、长城、小米等国内主流车企的供应商。公司产品广泛应用于新能源汽车、储能及工业控制场景，是绿色能源核心器件的赋能者。

（3）公司化合物半导体射频及光电芯片业务盈利能力显著改善，产品结构持续优化，高端

应用领域增长为业务注入新活力。与速腾聚创、禾赛科技、瑞识智能等达成战略合作，车规级 VCSEL 芯片大批量出货，销量 0.27 万片，同比大增 656.82%；pHEMT 芯片用于低轨卫星，已进入航空航天与卫星通信领域，销量 0.23 万片，同比增长 26.12%。

2026 年，公司将继续聚焦主营业务。生产方面将精准推进产能释放，着力强化规模效益，科学推进衢州、嘉兴 12 英寸硅片工厂、海宁 VCSEL 产线等重点项目的产能建设与达产，着力提升各产线产能利用率，通过规模化生产有效摊薄固定成本，增强整体成本竞争力。公司将深化三大板块协同价值，以上游硅片为核心起点，构建可同步为客户提供高效能功率芯片与先进射频及光电芯片的垂直整合平台。依托独特的平台化优势，充分发挥全链条协同的综合效能，精准捕捉三大细分行业交叉领域机遇（如智能汽车领域中同时涉及硅片、功率器件、射频及光电芯片的全品类核心产品需求），最大化释放协同潜力；同时推进技术、产能、供应链深度融合，凭借清晰的产品定位与精准的市场布局，构建稳定高效的营销体系，实现营收与利润稳步增长，强化抗风险能力与长期发展动力，通过扎实的业绩持续提升内在价值。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

公司坚持创新驱动战略，将技术研发作为核心竞争力提升的关键，2025 年公司研发投入 25,596.43 万元。研发技术团队得到有效充实，核心技术突破不断，为企业高质量发展奠定坚实基础。

（1）半导体硅片业务以重掺晶体生长配套外延沉积技术为核心根基，持续巩固领先地位，同步加快重掺磷、重掺砷超低阻产品的迭代开发。其中 12 英寸重掺砷、12 英寸重掺磷衬底外延片等多款产品采用了全球领先的超重掺杂单晶生长技术，满足 AI 服务器电源对高效率、高功率密度的苛刻工况要求。具有独创性的特色砷烷外延产品获得客户全方位认可，出货量及市场占有率强势攀升；12 英寸 MCZ 超低氧抛光片精准切入国内外高压 IGBT 市场并成功上量，广泛应用于新能源汽车、智能电网等领域；全尺寸系列高质量埋层外延产品在客户端验证通过，应用于高频滤波器的超高阻抛光片持续增量。同时全速推进 12 英寸轻掺硅片的快速上量和新客户拓展。公司 12 英寸轻掺硅片产品线坚持高端化、差异化发展路线，充分发挥深厚的外延工艺技术积淀，着力构建多元化的产品矩阵，区别于传统轻掺硅片过度集中于特定应用领域的市场格局，已在逻辑电路、BCD 工艺、PMIC 电源管理等非存储类应用领域形成全系列覆盖。其中，逻辑电路用轻掺砷外延片、BCD 工艺 PMIC 电源用轻掺砷抛光片等相较于普通常规轻掺抛光片具有更高议价能力的核心产品已在客户端快速上量；成功实现 CIS 器件应用领域 28nm 制程标志性突破。

(2) 功率器件芯片业务启动车规级产品全维度对标工程，建立与国际标杆的动态对齐机制，重点突破 FRD 结构优化、SJ MOS 导通损耗及 IGBT 开关特性等关键技术，新一代高频低损耗、高可靠性 FRD 芯片系列化产品在新能源汽车和工业控制领域实现国产替代；全年完成 225 款新品开发，其中 FRD 产品占比 20% 左右；SBD、TVS、MOS 各品类新品完成梯度开发与客户验证，其中新能源控制芯片迭代款实现 VR 提升 10%、VF 下降 2mV 的性能优化，产品竞争力显著提升。

(3) 化合物半导体射频及光电芯片业务聚焦高频高增益技术路线，推进低成本工艺研发与材料国产化替代双轨并行，在 pHEMT 方面，公司 pHEMT 技术可满足不同轨道卫星通信对射频芯片的多样化需求，可适配宇航级芯片、高端专用通信等高可靠应用场景，形成较高技术壁垒和准入优势。在 HBT 方面，自主开发的第三代 LH0Z 新工艺采用 ICP 干法结合湿法刻蚀，实现 0.5 μm T-Base 与 Ledge 结构，显著降低寄生电容、提升性能与可靠性。在光电芯片方面，背发光透镜 VCSEL 工艺已完成开发并实现客户送样；二维可寻址大功率 VCSEL 技术达全球领先水平；相关产品深度赋能车载激光雷达、智能视觉传感领域。整体而言，公司形成了多种类化合物射频器件及高性能光电器件双轮驱动的平台化能力，应用边界持续拓宽，多项工艺具备客户送样与规模量产条件，为下一阶段增长储备了关键技术。

2026 年，公司将保持高强度研发投入，聚力突破关键领域技术瓶颈。在半导体硅片业务方面，重点推进 12 英寸轻掺产品产能爬坡与更先进制程突破，加大超低阻单晶等核心工艺研发。在功率器件业务方面，着力攻克 SGT、IGBT、碳化硅基功率芯片、车规级模块及新一代新能源器件的关键技术。在射频及光电芯片业务方面，全力推动 VCSEL、GaN-on-SiC 等高端工艺的客户导入与量产，优化现有射频工艺平台。公司将完善研发项目制与激励机制，加速技术成果向量产与市场转化。

三、坚持共享成果，积极回报投资者

始终践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视股东回报与投资者关系管理工作，努力提升公司经营业绩，增强股东回报能力。制定并实施 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，聚焦主营业务发展，提升盈利能力，为股东创造更多价值。2025 年，公司在修订《公司章程》的过程中优化了现金分红的条件，努力提升投资者获得感和市场认同度。

2026 年，公司将按照《公司章程》规定的利润分配政策，坚持持续、稳定的现金分红机制。在全力提升经营质量、推动业绩增长的基础上，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡。同时将结合《杭州立昂微电子股份有限公司市值管理制度》，引导上市公司价值理性合理回归内在价值，助力企业良性发展。公司将与广大投资者一起，推动公司市值与经营质量长

期匹配，切实维护全体股东权益，与广大股东共同开创价值共享、合作共赢的美好未来。

四、完善公司治理，提升投资者沟通质量

2025年，公司持续完善公司治理制度体系，根据《公司法》及监事会改革专项工作的要求，由董事会审计委员会依法行使原监事会相应职权，增设职工代表董事，并对《公司章程》及配套议事规则、部分管理制度等进行了系统性修订和完善，不断夯实治理基础。公司高度重视与投资者的有效沟通，持续提升信息披露质量与透明度，积极拓展多元化、常态化沟通渠道。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的要求履行信息披露义务。2025年，公司通过股东会、业绩说明会、投资者热线、邮箱、上证e互动、现场调研等多种方式，建立并维护与投资者的良性沟通机制。同时探索新媒体传播，通过官方微信公众号定期发布推文，披露半年度报告、季度报告相关的可视化长图、解读视频等内容，让投资者能够直接、全面、清晰地了解公司经营情况和发展现状，助力投资者更好地进行价值判断。

2026年，公司将严格按照法律法规的最新要求，持续健全内控体系，提升治理现代化水平与风险防控能力，进一步夯实公司持续健康发展的治理根基。进一步多元化与投资者的沟通渠道，以投资者需求为导向，持续提升信息披露的可读性和便利性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值，不断增强投资者对公司未来发展的信心。

五、健全 ESG 体系，实现可持续发展

公司连续四年披露 ESG 报告，围绕“全球半导体供应链的卓越建设者、贡献者”愿景，结合可持续发展相关指引、标准和利益相关方诉求，完善管理体系，致力于实现自身可持续发展。公司将可持续发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时，推进环境友好建设。

2026年，公司将持续推动可持续发展，携手更多的客户、员工、股东/投资者、政府与监管机构、供应商、合作伙伴、社区及公众等各方利益相关者，共同打造更加美好的社会和可持续的未来。

六、强化关键少数责任

2025年，公司及时反馈传递资本市场各项管理要求，全力支持董事、高级管理人员参与监管机构举办的各种线上、线下培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。

2026年，公司将继续积极组织“关键少数”参加法律法规、公司治理等方面的培训，提升“关键少数”合规意识和专业素养，不断提升履职能力。同时，根据《上市公司治理准则》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，确保薪酬与绩效紧密挂钩，强化经营层与股东的

利益共担共享约束。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2026年4月28日